

先端電子デバイスパッケージと高密度実装における評価・解析技術特集号（和文論文誌 C）論文募集

先端電子デバイスパッケージと高密度実装における評価・解析技術特集編集委員会

ユビキタス社会の到来を迎え、携帯電話、デジタル家電、高周波無線通信機器などの電子機器は、更なる小型・薄型化や低コスト化、そして、高速動作を可能とする先端実装技術が求められています。また、地球環境問題に対する懸念から、低消費電力デバイスの実装や、低廃棄物排出の環境調和型プロセス、低エネルギー消費プロセスなどの、新たな実装技術、プロセス技術が注目されています。こうした高密度実装や実装プロセスを支える要素技術として、三次元積層技術、チップ積層技術（Chip on Chip: CoC, Chip on Wafer: CoW, Wafer on Wafer: WoW）、貫通電極形成技術、ウェーハ薄膜化技術、光・電気複合実装技術、MEMS 実装技術、ウェーハレベルパッケージ（Wafer Level Package）技術、低温接合技術などの研究開発の重要性が益々高まりつつあります。

一方、電子機器の小型・薄型化の実現、また、低消費電力デバイスを実装した電子機器の信頼性を向上させるためには、上記の先端実装技術とともに、高密度に実装されたデジタル回路が誤動作することなく正常に動作するための Signal Integrity や Power Integrity, EMC などの電気設計やデバイスの温度上昇を制御する放熱設計などの実装設計技術の発展も不可欠です。

本特集号では、最新の先端電子デバイスパッケージと実装設計技術、及び設計を支援する評価・解析技術に焦点を絞り、この研究分野における研究開発を更に進展させることを目的として、研究成果を集約した特集号の企画を行いました。平成 22 年 11 月号の発行を予定していますので、多くの方々の積極的な投稿をお願い致します。

1. 対象分野

- ・低エネルギー、省エネルギー実装プロセス
- ・ライフサイクルアセスメント(Life Cycle Assessment: LCA)及び環境影響評価技術
- ・低環境負荷実装プロセス
- ・鉛フリー(Pb-Free)はんだ技術
- ・環境規制対応基板
- ・エコマテリアル、環境調和型実装材料
- ・ハロゲンフリー（臭素 Br-Free）配線基板
- ・フラックスレスソルダーリング技術、無洗浄ソルダーリング技術
- ・ソルダーレス接続技術
- ・低温接合技術
- ・省スペース・高密度集積技術
- ・フリップチップ実装技術
- ・システムインパッケージ(System in Package: SiP)技術
- ・三次元積層技術
- ・チップ積層方式 (Chip on Chip: CoC, Chip on Wafer: CoW, Wafer on Wafer: WoW)
- ・ウェーハ薄膜化技術
- ・貫通電極形成技術
- ・高密度プリント配線板実装技術
- ・インタポーザ高密度実装技術
- ・高密度光実装技術
- ・光・電気複合実装技術
- ・MEMS 実装技術
- ・ウェーハレベルパッケージ (Wafer Level Package: WLP) 技術
- ・チップスケールパッケージ(Chip Scale Package: CSP)技術
- ・分解容易性設計
- ・評価, シミュレーション
- ・信頼性評価・分析技術

2. 論文の執筆と取扱い：

通常の和文論文誌と同様とし、論文は刷り上がりページ数 8 ページ程度、ショートノートは 2 ページ程度とします。執筆の詳細は「和文論文誌 C 投稿のしおり」を御参照下さい。（http://www.ieice.org/jpn/shiori/es_mokuji.html）

なお、査読後の再提出期間（通常は 60 日）を短縮する必要があることをあらかじめ御了承下さい。

2. 論文投稿締切： 2010 年 2 月 25 日（木）必着

3. 論文投稿方法

(A) 電子投稿

https://review.ieice.org/regist_j.aspx にアクセスし、投稿原稿の PDF ファイルと編集用データを登録して下さい。登録後に作成される投稿者チェックリスト・著作権譲渡書を投稿締切日までに学会事務局に電子メール添付、FAX、郵送のいずれかの方法で送付して下さい。

【注意】登録時点で原稿のアップロードが困難な場合、「郵送による投稿」を選択し、いったん登録を完了させて下さい。連絡先メールアドレスにメール（Notification registration completion）が送付されます。メール内に記載の URL にアクセスし、「電子投稿（ファイルアップロード）」から必ず投稿締切日までに原稿をアップロードして下さい。

(B) 郵送

https://review.ieice.org/regist_j.aspx にアクセスし、投稿論文データを登録して下さい。投稿者チェックリスト、著作権譲渡書、投稿原稿、編集用データを保存したメディアを投稿締切日までに学会事務局に到着するように郵送して下さい。封筒には特集号名を朱記して下さい。

郵便物送付先：電子情報通信学会 出版事業部 ソサイエティ誌出版課
〒105-0011 東京都港区芝公園 3-5-8 機械振興会館内

4. 問合せ先

日暮 栄治 東京大学 先端科学技術研究センター
Tel: 03-5452-5180, Fax: 03-5452-5184, E-Mail: eiji@su.t.u-tokyo.ac.jp

5. 特集編集委員会

編集委員長 原田高志（NEC）
編集幹事 大坂英樹（日立）、日暮栄治（東大）
編集委員 浅井秀樹（静岡大）、五百旗頭健吾（岡山大）、今中佳彦（富士通研）、石原昇（東工大）、齊藤成一（三菱電機）
高橋成正（日本IBM）、廣畑賢治（東芝）、福島誉史（東北大）、福本幸弘（パナソニック）